

中信证券股份有限公司
关于
北京晶亦精微科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年一月

目录

目录.....	1
声明.....	2
第一节 本次证券发行基本情况.....	3
一、保荐人名称.....	3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	3
三、发行人基本情况.....	4
四、保荐人与发行人的关联关系.....	5
五、保荐人内部审核程序和内核意见.....	6
第二节 保荐人承诺事项.....	7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论.....	8
一、保荐结论.....	8
二、本次发行履行了必要的决策程序.....	8
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件.....	9
四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件.....	10
五、发行人符合科创板定位要求.....	12
六、发行人面临的主要风险.....	13
七、发行人的发展前景评价.....	16
八、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》要求的核查事项.....	19
九、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查.....	20

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“本机构”）及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人情况

中信证券指定黄凯、肖尧作为晶亦精微首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

黄凯：男，保荐代表人，先后负责或参与了中国黄金混合所有制改革暨 IPO 项目、七一二 IPO 项目、安达维尔 IPO 项目、中航电子可转债项目、中国重工非公开项目、杰赛科技非公开项目、华电国际非公开项目、北斗星通非公开项目、北京科锐控制权收购项目、航发动力市场化债转股项目、中瓷电子重大资产重组项目、国电南瑞重大资产重组项目、北方创业重大资产重组项目、中国电科集团公司债项目、中国兵器工业集团公司债项目、华锦股份公司债项目、国电南瑞公司债项目等工作，作为保荐代表人参与了宝武碳业 IPO 项目、中航光电非公开项目、航天电子非公开项目。黄凯先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

肖尧：男，保荐代表人、注册会计师（非执业），先后负责或参与了有研硅 IPO 项目、德新交运重大资产置换项目、航天长峰重大资产重组项目、中航飞机重大资产重组项目、中瓷电子重大资产重组项目等工作。肖尧先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定李骥尧作为晶亦精微首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目协办人，指定王凯、宋杰、那一凡、赵凡、胡清彦、程崔巍、张子欧、袁震、孙一甘作为晶亦精微首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目组成员。

李骥尧：男，先后负责或参与了红蜻蜓 IPO 项目、江航装备 IPO 项目、有研硅 IPO 项目、博华科技 IPO 项目、中信特钢可转债项目、中航飞机非公开项目、成飞集成非

公开项目、东方明珠重大资产重组项目、东方园林重大资产重组项目等工作。李骥尧先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员执业情况联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系电话：010-60837525

三、发行人基本情况

公司名称：北京晶亦精微科技股份有限公司

英文名称：Beijing Semicore Microelectronics Equipment Co., Ltd.

统一社会信用代码：91110302MA01MRH182

注册资本：16,646.14 万元

法定代表人：景瑾

有限公司成立日期：2019 年 9 月 23 日

股份公司成立日期：2022 年 12 月 23 日

注册地址：北京市北京经济技术开发区泰河三街 1 号 2 幢 2 层 101

邮政编码：100176

联系电话：010-57989217

传真号码：010-57989219

互联网址：www.gegvs.com

电子信箱：skjw@gegvs.cn

主营业务：公司主要从事半导体设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备及其配件，并提供技术服务

本次证券发行的类型：首次公开发行股票并在科创板上市

公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理事务，负责人为于静，联系电话010-57989044。

四、保荐人与发行人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本发行保荐书签署日，中信证券全资子公司中信证券投资持有发行人 1.82% 股份。除此之外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。

此外，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的要求，科创板试行保荐人相关子公司“跟投”制度。保荐人将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票规模分档确定。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本发行保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本发行保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本发行保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本发行保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐人内部审核具体程序如下：

内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预约情况对项目进行现场内核。内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核员分别从法律和财务角度对项目申请文件进行初审。同时内核部结合项目情况，有可能聘请外部律师和会计师等专业人士对项目申请文件进行审核，为本机构内核部提供专业意见支持。由内核部审核员召集该项目的签字保荐代表人、项目负责人履行问核程序，询问该项目的尽职调查工作情况，并提醒其未尽到勤勉尽责的法律后果。

内核审议在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，提出书面反馈意见，内核会召开前由内核部汇总出具项目内核报告。内核委员会以现场会议方式履行职责，以投票表决方式对内核会议审议事项作出审议。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 2/3 以上的参会内核委员表决通过。内核部对内核意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（二）内部审核意见

2023 年 5 月 30 日，在中信证券大厦 25 层 2505 会议室召开了晶亦精微 IPO 项目内核会，内核委员会对该项目进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意将晶亦精微 IPO 项目申请文件对外申报。

第二节 保荐人承诺事项

一、保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

二、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。

三、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

五、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

六、保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

七、保荐人保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

九、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，自愿接受上海证券交易所的自律监管。

十、若因保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论

一、保荐结论

中信证券根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《保荐人尽职调查工作准则》《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告〔2012〕14号）《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函〔2012〕551号）和《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告〔2014〕11号）等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。

发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、本次发行履行了必要的决策程序

（一）董事会决策程序

2023年5月8日，发行人召开了第一届董事会第五次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于<公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案>的议案》等相关议案。

（二）股东大会决策程序

2023年5月23日，发行人召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案>的议案》等相关议案。

综上，保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

（三）保荐人意见

经核查，本保荐人认为：上述董事会、股东大会的召集和召开程序、召开方式、出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及发行人《公司章程》的相关规定，表决结果均合法、有效。发行人本次发行已经依其进行阶段，取得了法律、法规和规范性文件所要求的发行人内部批准和授权，授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件

保荐人依据《证券法》相关规定，对发行人是否符合《证券法》第十二条规定的发行条件进行了逐项核查，核查意见如下：

（一）发行人自整体变更设立为股份有限公司以来已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设置了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构。

（二）发行人自成立以来一直专注于半导体设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备及其配件，并提供技术服务。根据大华会计师出具的“大华审字[2023]0020407号”《审计报告》，发行人2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月实现营业收入分别为9,984.21万元、21,966.14万元、50,580.82万元和30,867.88万元；实现净利润分别为-976.49万元、1,418.40万元、12,824.37万元和9,330.20万元。发行人财务状况良好，具有持续经营能力。

（三）大华会计师审计了发行人最近三年及一期财务会计报告，并出具了标准无保留意见的“大华审字[2023]0020407号”《审计报告》。

（四）根据相关主体出具的书面确认并经公开查询，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

（五）发行人符合中国证监会规定的其他条件。

四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

本保荐人依据《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定，对发行人是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

（一）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份公司，具备健全且良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定

经核查发行人的发起人协议、公司章程、发行人工商档案、《营业执照》等有关资料，保荐人认为，发行人系根据《公司法》在中国境内设立的股份有限公司，发行人的设立以及其他变更事项已履行了必要批准、验资、工商注册及变更登记等手续，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司。经核查发行人设立登记及历次工商变更的证明文件，发行人于 2019 年 9 月 23 日完成有限责任公司设立，并于 2022 年 12 月 23 日整体变更为股份有限公司，保荐人认为，发行人持续经营时间已在 3 年以上。

经核查发行人历次股东大会、董事会和监事会的会议文件，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度，发行人自设立为股份有限公司以来已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设置了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等相关制度，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度。保荐人认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

（二）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定

根据发行人的相关财务管理制度以及大华会计师出具的标准无保留意见的“大华审字[2023]0020407 号”《审计报告》，并核查发行人的原始财务报表，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所

有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

根据发行人的财务管理制度和内部控制制度、大华会计师出具的“大华核字[2023]0013767号”《内部控制鉴证报告》，并核查发行人的内部控制流程及其运行效果，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

（三）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定

1、经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标、计算机软件著作权等资料，并结合对发行人董事、监事和高级管理人员的访谈等资料。保荐人认为，发行人资产完整，资产、人员、财务、机构、业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、经核查发行人历次股东大会、董事会会议文件，并核查发行人的实际经营情况，保荐人认为，发行人最近二年内主营业务为半导体设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备及其配件，主营业务没有发生重大变化。

经核查发行人历次聘请董事、高级管理人员的股东会决议及董事会决议，发行人最近二年内董事、高级管理人员没有发生重大不利变化。

自公司成立以来，控股股东和实际控制人所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。

3、经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈，并根据中伦律所出具的《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

（四）发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定

经核查发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得的工商、税务、社会保障及住房公积金等方面的主管机构出具的有关证明文件，并进

行公开信息查询，保荐人认为，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查发行人董事、监事和高级管理人员提供的个人简历、无犯罪记录证明及其分别出具的相关承诺，并核查股东大会、董事会、监事会运营记录，公司董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

五、发行人符合科创板定位要求

公司主要从事半导体设备的研发、生产、销售及技术服务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）下的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1、新一代信息技术产业”中“1.2.1 新型电子元器件及设备制造-3562*半导体器件专用设备制造”。公司所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2023年8月修订）》第四条（一）中所规定的“新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”中的“半导体和集成电路”行业。

公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2023年8月修订）》第五条的4项指标，满足科创属性的相关要求，具体情况如下：

科创属性相关指标	是否符合	指标情况
最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近3年累计研发投入金额 ≥ 6000 万元	☒ 是 ☐ 否	发行人最近三年（2020年度、2021年度、2022年度）累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 14.78%，最近三年研发投入金额累计 12,201.61 万元
研发人员占当年员工总数的比例 $\geq 10\%$	☒ 是 ☐ 否	截至 2022 年 12 月 31 日，发行人研发人员总计 62 人，占公司员工总数的比例为 28.05%
应用于公司主营业务的发明专利 ≥ 5 项	☒ 是 ☐ 否	截至 2023 年 7 月 31 日，发行人应用于主营业务的发明专利合计 90 项
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿元	☒ 是 ☐ 否	发行人最近三年（2020年度、2021年度、2022年度）营业收入复合增长率为 125.08%，最近一年营业收入为 5.06 亿元

经核查，保荐人认为发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐

暂行规定（2023年8月修订）》关于科创属性的相关规定，具有科创属性，符合科创板定位。

六、发行人面临的主要风险

（一）与发行人相关的风险

1、技术升级风险

为满足客户工艺需求，半导体设备中各核心模块的技术和控制系统会不断升级。在下游半导体制造厂商技术快速发展的背景下，半导体设备厂商的技术迭代升级也面临着巨大挑战。目前，公司已有4台12英寸CMP设备完成产品验证并确认收入。与同行业竞争对手相比，公司12英寸CMP设备仅能实现28nm及以上制程工艺，而美国应用材料和日本荏原可以实现3nm制程工艺、华海清科可以实现14nm及以上制程工艺（正在验证中）。如公司产品技术升级不能满足客户对更先进制程生产的需求，再或未来芯片制造颠覆性新技术的出现，都可能导致公司的核心技术及相关产品的先进程度下降，对公司的经营业绩造成不利影响。

2、8英寸CMP设备市场空间增长或12英寸CMP设备验证及市场拓展不及预期的风险

目前，发行人销售产品以8英寸CMP设备为主，已有4台12英寸CMP设备完成产品验证并确认收入，国内12英寸CMP设备领域华海清科的市场占有率较高。未来，可能受下游8英寸晶圆厂扩产速度放缓等因素的影响，导致8英寸CMP设备市场空间增长不及预期，进而影响公司8英寸CMP设备的销售收入；或未来公司12英寸CMP设备在下游客户验证进度、市场开拓情况不及预期，从而使得公司12英寸CMP设备销售未能贡献新的收入增长，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。

如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品、提供更好的价格和服务，或将CMP设备与其他优势设备打包出售，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。我国半导体设备市场的快速增长以及我国半导体设备的进口替代预期可能会吸引更多潜在的进入者，公司可能面临市场竞争加剧的风险。

3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为100.00%、99.23%、

88.21%和 84.14%。公司客户集中度较高的原因主要为下游行业具有集中度较高的特征，且预计未来仍将继续存在。公司客户集中度较高可能会导致公司在商业谈判中处于弱势地位，且公司的经营业绩与下游半导体厂商的资本支出密切相关，客户自身经营状况变化也可能对公司产生较大影响。如果公司后续不能持续开拓新客户或对单一客户形成重大依赖，将不利于公司未来持续稳定发展。

4、核心技术泄露的风险

作为高新技术企业，核心技术优势以及持续研发能力是公司的核心竞争力，也是公司保持技术领先和市场竞争优势的关键因素。公司拥有多项核心技术，为保护核心技术，公司通过与核心技术人员签订相关协议、规范研发过程管理、申请专利等保护措施防止核心技术泄露，但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露。若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄露，将对公司业务发展和研发进程造成不利影响。

5、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,386.49 万元、24,763.88 万元、31,036.60 万元和 26,549.58 万元，占当期总资产的比例分别为 26.23%、38.71%、24.07%和 21.79%，存货跌价准备金额分别为 0 万元、0 万元、27.98 万元和 132.99 万元。报告期内，公司存在预先采购部分原材料的情形，若后续产品设计或参数出现较大调整，则该部分原材料将发生减值。报告期各期末，公司按照存货跌价计提政策对存货进行减值测试，并计提存货跌价准备。公司存货金额较高，一方面对公司流动资金占用较大，导致一定的流动性风险；另一方面如市场环境发生变化，可能出现存货跌价减值的风险。

6、经营活动现金流量净额波动的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,422.85 万元、19,628.05 万元、4,736.45 万元和-6,725.91 万元。随着经营规模和研发规模的不断扩大，公司经营发展所需资金需求日益增加，公司经营活动现金流量净额若为负，则可能导致公司出现流动性风险。

7、对中芯国际存在依赖的风险

报告期内，公司向中芯国际销售收入占主营业务收入的比例分别为 71.17%、29.03%、49.71%和 50.67%，公司预计在未来一定时期内仍将存在对中芯国际的销售

收入占比较高的情形。2023 年，中芯国际 8 英寸晶圆收入下滑、平均单价环比下降，可能影响其 8 英寸 CMP 设备采购计划。如果未来公司新客户拓展计划不如预期，或中芯国际经营、采购战略发生较大变化，或公司与中芯国际的合作关系被其他供应商替代，或公司 12 英寸 CMP 设备在中芯国际产品验证进度及结果、订单获取不及预期，公司的业务发展和业绩表现将受到不利影响。

8、部分零部件进口产品比例较高的风险

报告期内，发行人主要原材料中机械标准件、流体控制元件采购进口产品的金额占其大类采购总额的比例较高。其中，机械标准件采购进口产品的金额占比分别为 60.75%、75.82%、81.15%和 80.54%，流体控制元件采购进口产品的金额占比分别为 77.14%、99.81%、97.61%和 99.49%。在上述原材料进口产品比例较高的情况下，受到全球产业链供给波动与贸易保护主义等因素的影响，如果发行人被禁止购买或无法按时取得该等原材料，则可能影响公司产品的正常生产与质量控制，对发行人的生产经营造成不利影响。

9、产品单一风险

报告期内，公司 CMP 设备销售收入分别为 9,796.85 万元、21,469.51 万元、49,558.66 万元和 30,007.00 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.12%、97.74%、97.98%和 97.21%，公司主营业务收入主要来源于 CMP 设备的销售，CMP 设备的销售收入较大程度上决定了公司的盈利水平。公司单一的产品类别，未来可能因 CMP 市场竞争加剧、产品价格下降或下游行业需求量下降导致公司的 CMP 设备销售量减少，将会对公司的经营业绩产生不利的影响。

10、募投项目达产后产能过剩的风险

在本次募投项目实施后，公司 8 英寸第三代半导体 CMP 设备、8 英寸传统硅基 CMP 设备的现有产能及募投项目新增产能之和为 18 台/年、55 台/年。根据测算，在公司募投项目达产的 2025 年及 2026 年，公司 8 英寸第三代半导体 CMP 设备、8 英寸传统硅基 CMP 设备的现有产能及募投项目新增产能之和占中国大陆市场新增 CMP 设备台数的比例为 163.64%、150.00%与 148.65%、141.03%；占中国台湾市场新增 CMP 设备台数的比例为 150.00%、138.46%与 250.00%、239.13%；占中国大陆及中国台湾市场新增 CMP 设备台数之和的比例为 78.26%、72.00%与 93.22%、88.71%；占全球市场新增 CMP 设备台数

的比例为 27.27%、25.35%与 38.46%、37.41%。如果未来 8 英寸 CMP 设备的市场需求发生重大变化或公司的市场开拓不及预期，可能会导致公司出现 8 英寸 CMP 设备产能过剩的情况，对公司的业务发展与经营业绩造成不利影响。

（二）与行业相关的风险

1、宏观经济及行业波动风险

公司所处的半导体设备行业是半导体产业链的关键支撑行业，其需求受下游半导体厂商资本支出及终端消费市场需求波动的影响较大。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，则可能导致半导体制造厂商面临产能过剩的局面。根据中芯国际及 Trend Force 披露数据，2023 年 4 季度全世界的 8 英寸晶圆制造产能利用率在 50%-70%附近，产能利用率较低，未来半导体制造厂商可能会削减未来资本支出，进而削减对半导体设备的采购金额，对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

（三）其他风险

1、募集资金投资项目风险

募投项目开始实施后，公司拟进行大额研发投入并陆续新增固定资产、无形资产的投资，导致相应的研发支出、折旧与摊销出现增加。募投项目实施的前三年，预计各年将分别新增研发支出 9,095.88 万元、12,792.57 万元和 10,659.34 万元，合计 32,547.79 万元；新增折旧与摊销 2,558.18 万元、3,031.00 万元和 3,493.70 万元，合计 9,082.88 万元。如果宏观经济形势、市场竞争格局或市场需求发生重大变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，则新增的研发投入和折旧与摊销将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、即期回报被摊薄与净资产收益率下降的风险

本次发行后，公司资本实力将得到增强，净资产将大幅增加。但募集资金投资项目需要一定的投入周期，在短期内难以完全产生效益，因此公司在发行当年每股收益及净资产收益率受股本摊薄影响，可能出现下降，从而导致公司即期回报被摊薄。

七、发行人的发展前景评价

公司主营业务为半导体设备的研发、生产、销售及技术服务。报告期内，公司经营

业绩增长较快，表现出较强的盈利能力。基于以下分析，保荐人认为，公司具有良好的发展前景：

（一）发行人在国内同行业中处于领先的市场地位

公司及公司前身四十五所 CMP 事业部一直致力于 CMP 设备的研发、产业化及技术自立自强。2017 年，公司前身四十五所 CMP 事业部研制出国内首台拥有自主知识产权的 8 英寸 CMP 设备，并于当年进入中芯国际产线进行验证，填补了国产 8 英寸 CMP 设备在集成电路制造生产线的运行空白。公司自 2019 年成立以来，完成了 8 英寸 CMP 设备的批量销售，成功实现产业化应用，被天津集成电路产业特色工艺创新联盟授予“杰出装备供应商——8 英寸 CMP 设备置换率达 100%”奖项，在部分客户产线中实现 100% CMP 进口设备替代。公司立足国际市场，是目前国内唯一实现 8 英寸 CMP 设备境外批量销售的设备供应商。公司 12 英寸 CMP 设备已在 28nm 制程国际主流集成电路产线完成工艺验证，设备性能和技术指标均可满足该客户产线要求；截至本发行保荐书签署日，已获得多家客户订单。同时，公司把握第三代半导体发展机遇，推出了国产 6/8 英寸兼容 CMP 设备，可用于包含碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料在内的特殊需求表面抛光处理工艺。

公司所在行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，生产工艺复杂，企业的发展需要较强的研发实力和技术积累，技术人员和生产人员需具备很强的专业知识和实际操作能力。公司由数十名超过 15 年产线 CMP 应用经验的资深专家，六十多位设计研发人员，研发团队实力雄厚。公司对主要核心技术取得了专利保护，截至 2023 年 7 月 31 日，公司共拥有境内发明专利 85 项、中国台湾发明专利 5 项和境内实用新型专利 3 项。

公司及公司前身四十五所 CMP 事业部研制出国内首台拥有自主知识产权的 8 英寸 CMP 设备，填补了国产 8 英寸 CMP 设备在集成电路制造生产线的运行空白。同时，公司立足国际市场，是目前国内唯一实现 8 英寸 CMP 设备境外批量销售的设备供应商。

（二）发行人未来发展面临良好的外部市场环境

为实现芯片垂直空间的有效利用，多层金属化技术被应用到半导体制造工艺中。随着各种工艺层被刻蚀成图形，晶圆表面变得高低起伏，导致晶圆表面呈现出不同的反射性质，难以达到良好的分辨率；同时，电路电阻值增高，稳定性下降。化学机械抛光技术依靠其优秀的全局平坦化能力、广泛的适用性以及低成本特点逐渐成为半导体制造过

程中的主流平坦化技术。随着半导体技术的发展、芯片集成度的提高，CMP 设备的重要性以及在半导体产业链中的投资占比也逐步增加。

近年来，我国陆续推出了多项产业支持政策，推动了半导体设备行业发展并加速了半导体设备的国产化进程。《国家集成电路产业发展推进纲要》明确指出：鼓励企业在集成电路关键装备和材料领域进行技术突破；《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019 年版）》中将化学机械抛光机作为集成电路生产装备之一列入目录；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确集中优势资源攻关核心技术，半导体设备作为集成电路领域的重点装备亦被纳入其中。

中国大陆是全球最大的电子终端消费市场和半导体销售市场，吸引着全球半导体产业向大陆的迁移。近年来，中美贸易摩擦凸显出供应链安全的重要性和紧迫性，半导体设备制造作为半导体产业的基石将迎来高速发展。

综上，在半导体技术高速发展、国家产业政策支持、半导体产业迁移等多重利好因素的驱动下，中国 CMP 设备行业有望进入快速增长阶段。

（三）本次募集资金投资项目的实施将进一步增强发行人的成长能力

1、提升产品技术水平，推动半导体装备国产化替代进程

全球 CMP 设备市场主要由美国应用材料和日本荏原占据，处于高度垄断状态。根据 Gartner 数据，上述两家制造商的 CMP 设备全球市场占有率超过 90%，尤其在 14nm 以下先进制程工艺产线上使用的 CMP 设备主要由美国应用材料和日本荏原两家国际巨头提供。本次募集资金投资项目通过对整机智能化开发、下一代亚纳米级 CMP 技术、下一代先进 12 英寸 CMP 设备及成套工艺等关键技术的研究，进一步增强公司技术储备，提升产品技术水平，推动我国半导体设备国产化替代进程。

2、扩大现有产能，抓住芯片制程工艺升级带来的 CMP 设备采购需求

随着芯片制程工艺的升级，CMP 设备市场规模将迎来新的增长点。随着芯片制程的不断缩小，CMP 工艺在半导体生产流程中的应用次数逐步增加，以逻辑芯片为例，65nm 制程芯片需经历约 12 道 CMP 步骤，而 7nm 制程芯片所需的 CMP 处理则增加为 30 余道，CMP 设备应用将更为频繁。本次募集资金投资项目的实施将扩大公司现有产品产能，有助于公司抓住芯片制程工艺升级带来的市场 CMP 设备采购需求扩张机遇。本次募集资金投资项目的建设有利于加强公司持续盈利能力，巩固并增强公司市场地位，

提升公司整体竞争力及品牌知名度。

3、构建专业化研发平台，吸引专业人才

自主研发能力是企业之间竞争的核心，半导体设备企业的研发能力主要体现在专业的人才储备。随着下游需求的持续升级换代，公司现有研发设备及研发人员已无法满足更精密及更高端技术深度开发的要求。本次募集资金投资项目通过购置先进研发测试设备，改善技术研发人员的工作条件，构建专业化研发平台，吸引和容纳更多行业内优秀研发人员，提升公司整体研发能力。

八、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》要求的核查事项

中信证券在晶亦精微首次公开发行股票并在科创板上市项目工作中，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所担任本次证券发行的保荐人/主承销商会计师，为本机构提供相关财务咨询服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所统一社会信用代码为 913301003281200493，具备从事证券业务资格；聘请北京观韬中茂律师事务所担任本次证券发行的保荐人/主承销商律师，为本机构提供相关法律咨询服务。北京观韬中茂律师事务所统一社会信用代码为 31110000400841036J，具备从事证券法律业务资格。

经保荐人核查，上述聘请第三方的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。除上述聘请行为外，保荐人不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。

经保荐人核查，截至本发行保荐书签署日，发行人在首次公开发行股票并在科创板上市项目工作中，除中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司等依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，具体为：1、聘请了北京荣大科技股份有限公司为本次发行上市提供编制募集资金投资项目可行性研究报告、申报文件制作、底稿电子化等服务；2、聘请了北京慕迪灵翻译有限公司对发行人重大合同中的外文合同进行了翻译。除上述聘请行为外，发行人不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。

九、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查

（一）核查对象

截至本发行保荐书签署日，发行人全体股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	四十五所	5,632.85	33.84%
2	电科装备	5,000.00	30.04%
3	电科投资	1,500.00	9.01%
4	烁科精微合伙	1,500.00	9.01%
5	大基金二期	453.99	2.73%
6	联通创投基金	380.17	2.28%
7	聚源芯创基金	302.66	1.82%
8	国新双百基金	302.66	1.82%
9	中信证券投资	302.66	1.82%
10	桐誉基石投资	302.66	1.82%
11	国开科创有限	151.33	0.91%
12	中芯熙诚基金	151.33	0.91%
13	杭州安芯基金	151.33	0.91%
14	蓉创股权投资	151.33	0.91%
15	国新国控有限	90.80	0.55%
16	中信建投投资	90.80	0.55%
17	合肥产投投资	90.80	0.55%
18	无锡新动能基金	90.80	0.55%
合计		16,646.14	100.00%

（二）核查方式

保荐人通过查阅公司现有法人股东的工商资料 and 公司章程等制度文件、浏览法人股东网站及中国证券投资基金业协会网站、发行人律师出具的律师工作报告等方式，对发行人股东是否属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规规范的私募投资基金进行了核查。

（三）核查结论

截至本发行保荐书签署日，发行人共有 18 名股东，根据《私募投资基金监督管理

暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规的规定，其中大基金二期、联通创投基金、聚源芯创基金、国新双百基金、桐誉基石投资、中芯熙诚基金、杭州安芯基金、蓉创股权投资、合肥产投投资、无锡新动能基金属于上述规定规范的私募投资基金。

经核查，发行人上述全部私募投资基金股东均已根据上述法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了基金备案及管理人登记手续，具体情况如下：

序号	股东名称	基金备案号	基金管理人	管理人登记编号
1	大基金二期	SJU890	华芯投资管理有限责任公司	P1009674
2	联通创投基金	SGT377	联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司	GC2600031589
3	聚源芯创基金	SSV020	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	P1003853
4	国新双百基金	SJE713	国改双百发展基金管理有限公司	P1070238
5	桐誉基石投资	SVV096	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业	P1000502
6	中芯熙诚基金	STL648	中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司	P1072072
7	杭州安芯基金	SSF587	福建省安芯投资管理有限责任公司	P1060140
8	蓉创股权投资	SVN300	成都创新风险投资有限公司	P1022366
9	合肥产投投资	STR199	合肥产投资本创业投资管理有限公司	P1071755
10	无锡新动能基金	SEN946	无锡新投金石创业投资管理有限公司	P1069035

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京晶亦精微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页)

保荐代表人：

黄凯

黄 凯

肖尧

肖 尧

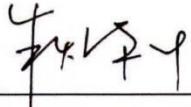
项目协办人：

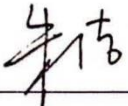
李骥尧

李骥尧



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京晶亦精微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页）

保荐业务部门负责人： 
朱烨辛

内核负责人： 
朱 洁

保荐业务负责人： 
马 尧


中信证券股份有限公司
2018 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京晶亦精微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页）

总经理：

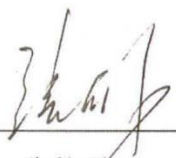


杨明辉



（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京晶亦精微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页）

董事长、法定代表人：


张佑君

中信证券股份有限公司



2024年1月25日

保荐代表人专项授权书

本人，张佑君，中信证券股份有限公司法定代表人，在此授权公司黄凯、肖尧担任北京晶亦精微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，负责北京晶亦精微科技股份有限公司本次发行上市工作及股票发行上市后对北京晶亦精微科技股份有限公司的持续督导工作。

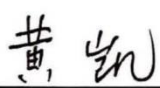
本授权有效期限自授权之日起至持续督导期届满止。如果公司在授权有效期限内重新任命其他保荐代表人替换黄凯、肖尧负责北京晶亦精微科技股份有限公司的保荐工作，本授权书即行废止。

特此授权。

法定代表人：


张佑君（身份证 110108*****210058）

被授权人：


黄 凯（身份证 371323*****212113）


肖 尧（身份证 341224*****220212）



中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 25 日